

**【東京/武蔵村山】品質保証リーダー候補 ◆ヤマハ発動機グループ**

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。品質管理・品質保証（技術系）のご経験...

## Job Information

**Recruiter**

JAC Recruitment Co., Ltd.

**Hiring Company**

ヤマハロボティクス株式会社

**Job ID**

1594516

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Tokyo - Other Areas

**Salary**

4.5 million yen ~ 7.5 million yen

**Work Hours**

08:45 ~ 17:30

**Holidays**

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日～15日 4か月目から【休日】完全週休二日制...

**Refreshed**

May 28th, 2026 16:23

## General Requirements

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Daily Conversation

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Technical/Vocational College

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

## Job Description

【求人No NJB2335254】

■組織構成：組織：品質保証部

■業務内容

品質不具合対応、再発未然防止、信頼性評価など、品質保証業務全般を担当いただきます。  
1.市場および自社内品質不具合の一次故障解析と再発・未然防止実施までのフォローアップ  
2.監査を含む協力会社（日本国内および海外サプライヤ）の品質管理

- 3.新規開発品の品質・信頼性評価およびDR（デザインレビュー）を含む開発ゲート管理
- 4.品質情報のデジタル化推進およびデータ活用による品質改善
- 5.品質マネジメントシステム（QMS）の更新・維持・管理

#### ■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競争が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

#### [取扱い製品]

ワイヤボンダ、ダイボンダ、パンプボンダ、フリップチップボンダ、等

#### □主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。  
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに替わる新しい実装技術になります。  
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを製造する為の装置です。  
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

#### Required Skills

##### ■必須（主務クラスに求めている内容）

- ・機械系メーカーでの品質保証経験
- ・以下のいずれかのご経験  
故障解析～再発・未然防止/サプライヤ管理/信頼性評価/DR/品質情報管理のDX化/QMSの維持管理

##### ■尚可（主務クラスに求めている内容）

- ・マネジメント経験や社内および協力会社への品質改善指導経験

#### Company Description

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。